



**Einfache und schnelle
Prüfprogrammerstellung**

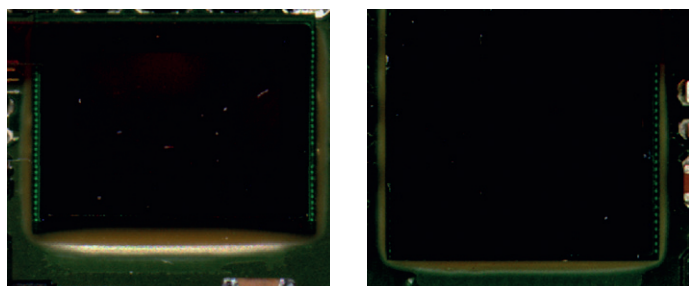
**Extrem hoher Durchsatz durch
Viscom FastFlow Handling**

**Leistungsstarke Inspektion
von Underfills**

Zuverlässige Inspektion von Underfills

Das Inspektionssystem S3088 UFI wurde gezielt für eine sichere, wirtschaftliche Fehlerdetektion und schnelle Prozessoptimierung entwickelt. Ein flexibles Prüfkonzept mit skalierbarer und modularer Sensorik ermöglicht die Inspektion von Underfills an z. B. BGAs oder Flip Chips – vom Prototypen bis zur Großserie. Das Viscom FastFlow Handling sorgt mit dem gleichzeitigen Zu- und Abführen von Baugruppen für extrem kurze Handlingzeiten von minimal 2,5 s. Die hohe Auflösung der orthogonalen Sensorik mit bis zu 11,75 µm/Pixel gewährleistet eine zuverlässige Erkennung auch kritischer Fehler, optional durch Seitenkameras mit einer Auflösung von 8 µm/Pixel unterstützt. So werden auch kleinste Fehlstellen präzise detektiert.

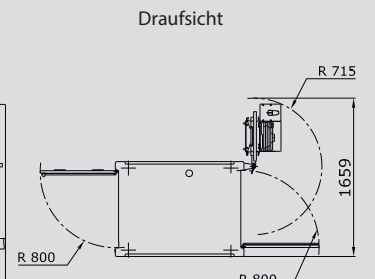
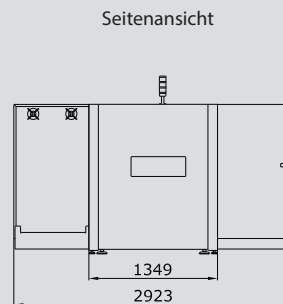
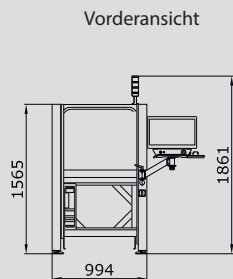
Ein weiteres intelligentes Feature der Viscom-AOI ist die integrierte Fehlerverifikation. Sie sichert die Fehlerfindung bei gleichzeitiger Verbesserung des First Pass Yields. Systembediener haben damit ein komfortables Tool für die Null-Schlupf-Strategie. Viele leistungsstarke Zusatzmodule wie Offline-Programmierung oder SPC-Auswertung runden das Angebot ab.



Verschiedene Ausprägungen von Underfill (hell)

AOI

Technische Daten



Angaben in mm

S3088 UFI		
Inspektionsumfang	AOI	Inspektion von Underfills (optional: Selektivlöten, vollflächige Wellenlötung, Bestückungskontrolle)
Sensorik	Orthogonales Kameramodul 8M	
	Bildfeldgröße	57,6 mm x 43,5 mm
	Auflösung	11,75 µm
	Anzahl der Megapixelkameras	4
	Schrägsichtsmodul 8M (optional)	
	Auflösung	8 µm
	Anzahl der Megapixelkameras	4 oder 8
Software	Bedienoberfläche	Viscom EasyPro/vVision
	SPC	Viscom SPC (statistische Prozesskontrolle), offene Schnittstelle (optional)
	Verifikationsplatz	Viscom HARAN/vVerify
	Remote-Diagnose	Viscom SRC (optional)
	Programmiersplatz	Viscom PST34 (optional)
Systemrechner	Betriebssystem	Windows®
	Prozessor	Intel® Core™ i7
Leiterplattenhandling	Leiterplattengröße	508 mm x 508 mm (L x B)
	Übergabehöhe	900 - 950 mm ± 20 mm
	Breitenverstellung	Automatisch beim Rüsten
	Transportkonzept	Einspur-Transport
	LP-Klemmung	Pneumatisch
	Obere Durchfahrtshöhe	50 mm
	Untere Durchfahrtshöhe	60 mm
Prüfgeschwindigkeit		20 - 40 cm ² /s
Sonstige Systemdaten	Verfahr-/Positioniereinheit	Synchron-Linearmotoren
	Schnittstellen	SMEMA
	Anschlusswerte	230 V (andere Spannungen auf Anfrage), 1P/N/PE, 10 A
	Systemmaße	994 mm x 1565 mm x 1349 mm (B x H x T)
	Gewicht	600 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Windows® und Intel® Core™ i7 sind eingetragene Warenzeichen.